

Unser Job. Ihre Sicherheit.

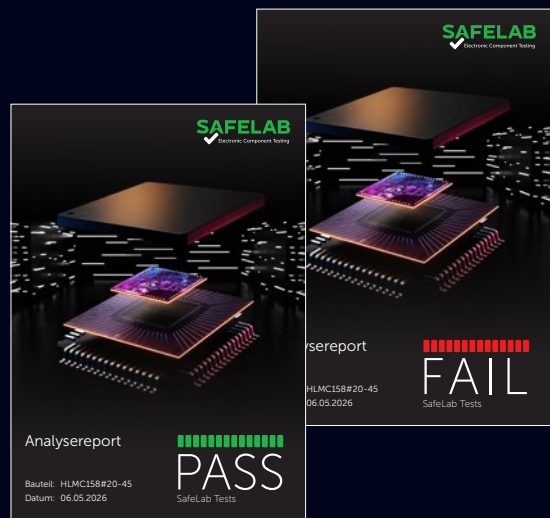
Sie wollen wissen, ob ein elektronisches Bauteil original und neu ist? Sie benötigen eine schnelle und zuverlässige Antwort?

SafeLab prüft in Ihrem Auftrag.

Wir analysieren – Sie brauchen nichts weiter zu tun.

Sobald der Testreport zur Verfügung steht, haben Sie eine eindeutige Antwort auf Ihre Frage: **PASS oder FAIL.**

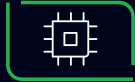
Unsere Analyse-Spezialisten beraten Sie gerne kostenlos und stimmen mit Ihnen die erforderlichen Prüfabläufe ab. So vermeiden Sie unnötige Kosten und geben nur notwendige Dienstleistungen in Auftrag.



Hightech-Analysen. Klare Aussagen.

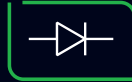
- ✓ **Schnelles Testergebnis**
i.d.R. innerhalb von sieben Werktagen
- ✓ **Klarheit auf den ersten Blick**
Eindeutiges Ergebnis auf dem Deckblatt
- ✓ **Konkrete Handlungsempfehlung**
zur Verwendbarkeit des Bauelements

Unsere Stärke. Unsere Produktkategorien.



Integrierte Schaltkreise (ICs)

Bauteile mit einem oder mehreren integrierten Chips (Dies).
Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Speicher, ASICs, DSPs, A/D-Wandler, FPGAs etc.



Dioden

Zenerdioden, Diac, Thyristoren, LED, Photodioden, Laserdioden etc.



Kapazitäten (C)

Kondensatoren, MLCC, Elko, Superkondensatoren, SuperCap, EDLC etc.



Widerstände (R)

Potentiometer, Präzisionswiderstände, Photowiderstände, NTC, PCT, Varistoren etc.



Transistoren

MOSFET, IGBT, Triac, Bipolartransistoren, FET, Optokoppler etc.



Induktivitäten

Spulen, Übertrager, Drosseln, Transformatoren, Luftspulen, Elektromagnete etc.



Schaltelemente

Relais, SSR, Schütze, Halbleiterrelais, Schalter, Taster, Reedrelais, Reedkontakte etc.



Stromversorgungen

Batterien, Akkus, Power Supply, Netzteile, PSU, Schaltnetzteile etc.



Schadenanalysen

Ermittlung der Ursache defekter Bauteile und Baugruppen etc.

Unsere Kompetenz. Unsere Analysemethoden.

Visuelle Inspektion



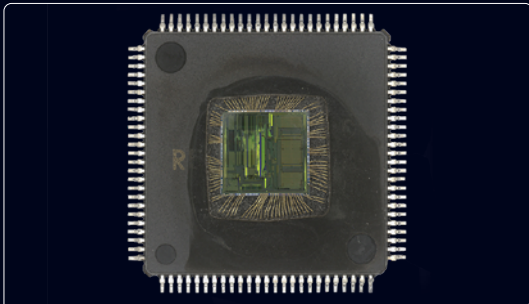
Mikroskopische Betrachtung sämtlicher Bauteiloberflächen, digitale Vermessung auf Maßhaltigkeit.

Oberflächenanalyse



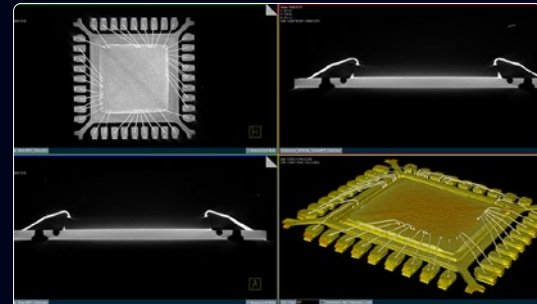
Chemische, mechanische und chemisch-thermische Verfahren. Untersuchung der Bauteilkennzeichnung und des Gehäuses auf Manipulationen.

Bauteilöffnung



Freilegung des Bauteil-Innenlebens mittels chemischer oder mechanischer Verfahren zur Überprüfung auf Originalität und Fehlerfreiheit. Destruktives, aber aussagekräftigstes Verfahren, speziell bei komplexeren Halbleiterbauteilen.

Röntgeninspektion



Hochauflösende Untersuchung von Bauteilen und Baugruppen in 2D-, 2.5D- und 3D/CT-Technik. Zerstörungsfreies Verfahren zur Originalitätsprüfung und Qualitätssicherung.

